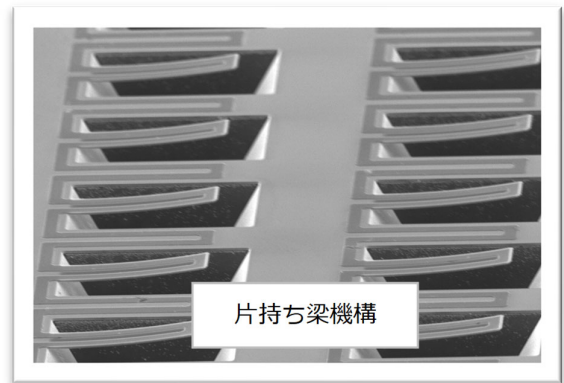
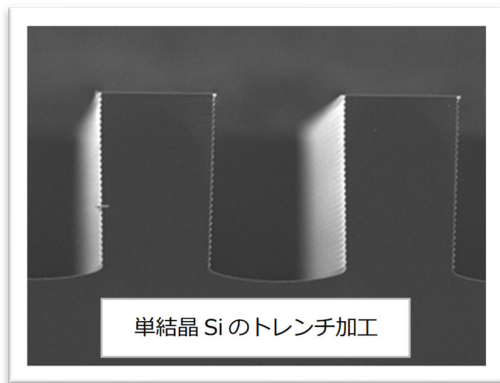


実験動画で学ぶエッチング工程

～ウェットエッチング・ドライエッチング～



日時

配信開始日時：2026年7月1日(水) 10:00

配信終了日時：2026年9月30日(水) 23:59

(配信期間中は何度でも視聴できます)

受講申込期限

2026年

8月25日(火)

16:00

受講料

1,000 円

定員

なし

特徴

- ・ 実際の動画で装置や実験の様子を視聴可能
- ・ 微細加工、微細構造形成に関心のある方向け
- ・ エッチング技術をこれから学びたい方にも最適

詳細は裏面またはこちら



お問い合わせ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター お客様支援室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308

メール宛先：kenshu@iri-tokyo.jp

(お問い合わせには、営業日のみ対応いたします)



技術セミナー(オンデマンド配信・オンライン決済対応)

実験動画で学ぶエッチング工程 ～ウェットエッチング・ドライエッチング～

概要

半導体・MEMS センサや、光学素子、マイクロ流路等にみられるナノ～マイクロメートルスケールの3次元デバイスの製造工程では、半導体加工技術を応用したシリコンウェハ等の微細加工が行われております。本オンデマンド配信では、反応性イオンエッチング (RIE) やシリコン深堀エッチング等のドライエッチング技術、特殊な微細形状を安価に得られる単結晶シリコン結晶軸異方性ウェットエッチング技術について、実験室レベルの工程を紹介します。また、片持ち梁アクチュエータ加工事例を紹介し、加工の流れについても理解を深めていただきます。これから微細加工やエッチング技術の知識を深めたいと考えている方のご参加をお待ちしております。

※1 本配信の内容は、昨年度に配信した同タイトルと同様です。

※2 配信動画の著作権は都産技研に帰属します。録音・録画はご遠慮ください。

プログラム

動画の長さ	タイトル	講師 (担当者)
約60分	1. 半導体工程によるナノ・マイクロスケールの微細加工 2. エッチングの概要 3. ウェットエッチング 4. ドライエッチング 5. 加工事例の紹介	東京都立産業技術研究センター 固体デバイス技術グループ 谷口 達彦 (本動画の解説には、音声読み上げソフトを使用します)

募集要項

利用約款

下記ウェブページでご確認ください。

<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/>

応募資格

原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これらに準ずる公的機関

申込方法

下記ウェブページから都産技研オンデマンド配信サイトにアクセスしてください。

<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/seminar-260701-1/>

同サイトでアカウント登録後、ご視聴を希望する動画を選択し、受講料の支払い手続きにお進みください。

支払方法

サムネイル上に表示されている「料金を見る」をクリックした後、クレジットカード払いまたは銀行振込を選択し、オンラインで受講料をお支払いください。

その他

- 1 都産技研オンデマンド配信サイトのアカウント登録は承認制です。承認または不承認の判断は、原則としてアカウント登録の申請時から8営業日以内に行います(迅速に対応するように努めます)。
- 2 クレジットカード払いの場合、支払い手続き後、すぐに動画を視聴できます。銀行振込の場合、請求書発行後30日以内にお支払いください。入金確認には最大2営業日かかり、視聴権限の付与にはさらに日数を要す場合があります。
- 3 視聴環境(パソコン、スマートフォン等)は、受講者をご準備ください。都産技研オンデマンド配信サイトにある「視聴確認用サンプル動画」が再生できることを確認した後、ご視聴を希望する動画にお申し込みください。